

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 4 年 2 月 7 日(2022.2.7)

【公開番号】特開 2020-167251(P2020-167251A)  
【公開日】令和 2 年 10 月 8 日(2020.10.8)  
【年通号数】公開・登録公報 2020-041  
【出願番号】特願 2019-65394(P2019-65394)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60(2006.01)

10

H 0 1 L 33/00(2010.01)

H 0 5 K 13/04(2006.01)

H 0 5 K 13/02(2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 Q

H 0 1 L 33/00 H

H 0 5 K 13/04 Z

H 0 5 K 13/02 J

【手続補正書】

20

【提出日】令和 4 年 1 月 28 日(2022.1.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

転写元基板から転写された、互いに分離した、多数のチップ部品を保持し、加熱および加圧を行なう工程を経て、転写先基板に転写するのに用いる転写基板であって、  
ベース基板と、前記ベース基板表面に形成された未硬化の熱硬化性粘着剤からなる島状粘着部とを備えた転写基板。

30

【請求項 2】

請求項 1 に記載の発明であって、前記島状粘着部を形成する熱硬化性粘着剤がシリコーン樹脂であって、  
金属マスクを用いたスキージ塗布により前記島状粘着部が形成された転写基板。

【請求項 3】

ウエハ上に形成され、互いに分離した、電極を有する多数のチップ部品を、  
前記電極側を保持する第 1 転写基板に転写した後に、  
前記電極の反対側を保持する第 2 転写基板に転写してから、  
配線基板の所定位置にチップ部品を対向配置した状態で、前記チップ部品に前記第 2 転写基板越しにレーザー光を照射して、前記チップ部品を前記配線基板に転写配置して実装する実装方法であって、  
前記第 1 転写基板として、請求項 1 または請求項 2 に記載の転写基板を用いる実装方法。

40

【請求項 4】

前記チップ部品として LED チップを、前記配線基板として TFT 基板を用い、  
請求項 3 に記載の実装方法を用いて画像表示装置を製造する、画像表示装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

50

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 8 】

上記課題を解決するために、請求項 1 に記載の発明は、転写元基板から転写された、互いに分離した、多数のチップ部品を保持し、加熱および加圧を行なう工程を経て、転写先基板に転写するのに用いる転写基板であって、ベース基板と、前記ベース基板表面に形成された未硬化の熱硬化性粘着剤からなる島状粘着部とを備えた転写基板である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

10

【補正対象項目名】 0 0 1 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 9 】

請求項 2 に記載の発明は、請求項 1 に記載の発明であって、前記島状粘着部を形成する熱硬化性粘着剤がシリコーン樹脂であって、金属マスクを用いたスキージ塗布により前記島状粘着部が形成された転写基板である。

20

30

40

50